



2026年3月期 第3四半期決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2026年2月5日

3Q累計業績サマリー

* 3Q累計：4月～12月

■ 売上高・利益

➤ 前年比 増収増益

売上高 662億円（17%増）、営業利益 123.3億円（33%増）

SPE分野が増加、特に半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加。

■ 業績予想

➤ 通期業績予想を上方修正

売上高 880億円、営業利益 150億円、ROS 17.0 %

➤ 期末配当予想を上方修正（増配）、また、1株につき5株の割合で株式分割を実施予定。

配当 58.0円（株式分割後）：分割前290円に相当

■ 受注高

➤ 受注は回復基調

受注高693億円（27%増）、2Q比（QoQ）21%増加

特に生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。

2025/3Q 実績 (1)

3Q累計業績結果（対前年）①

(単位：億円)

	2024						2025			3Q 累計	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	3Q 累計	4Q	年度	1Q	2Q	3Q		
売上高	171	193	202	566	243	809	215	208	239	662	+17%
営業利益	30.7	26.8	35.5	93.0	48.4	141.4	40.6	35.1	47.6	123.3	+33%
ROS	17.9%	13.9%	17.6%	16.4%	19.9%	17.5%	18.9%	16.9%	19.9%	18.6%	+2.2pt
経常利益	31.4	24.1	36.3	91.8	48.0	139.8	40.7	33.0	47.3	121.0	+32%
当期純利益	22.9	18.1	28.5	69.5	33.8	103.3	28.7	24.5	35.3	88.5	+27%
受注高	213	156	176	545	153	698	179	233	281	693	+27%

2025/3Q 実績 (2)

3Q累計業績結果（対前年）②

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

■ 売上高 前年比 17%増収 (566億円 ⇒ 662億円)

➤ SPE分野が増加、特に半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加。

■ 営業利益 前年比 33%増益 (93.0億円 ⇒ 123.3億円)

➤ SPE分野の売上増加により増益。

■ 受注高 前年比 27%増加 (545億円 ⇒ 693億円)

➤ 半導体前工程は、高水準であった前年と同等、半導体後工程は好調であった前年を大幅に上回る水準で推移、SPE分野全体では前年に比べ増加。

2025/3Q 実績 (3)

セグメント別 3Q累計業績結果（対前年）①

■ フайнメカトロニクス部門

* フайнメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

- 売上高 前年比 4%増 (353億円 ⇒ 368億円)

半導体前工程では、マスク向け装置、パワーデバイス向け装置が低調に推移し前年に比べ減少、ロジック／ファウンドリ向け装置が順調に推移したほか、保守・サービス関係が寄与し、全体では前年に比べ増加。

FPD前工程では、低調で減少。

- セグメント利益 前年比 1%増 (56.3億円 ⇒ 56.7億円)

売上増加により増益。

- 受注高 前年比 17%増 (334億円 ⇒ 390億円)

半導体前工程では、マスク向け装置が順調に推移。ロジック／ファウンドリ向け装置が回復基調となったほか、保守・サービス関係が寄与し、全体では前年に比べ増加。

FPD前工程では、前年に比べ増加。

2025/3Q 実績 (4)

セグメント別 3Q累計業績結果（対前年）②

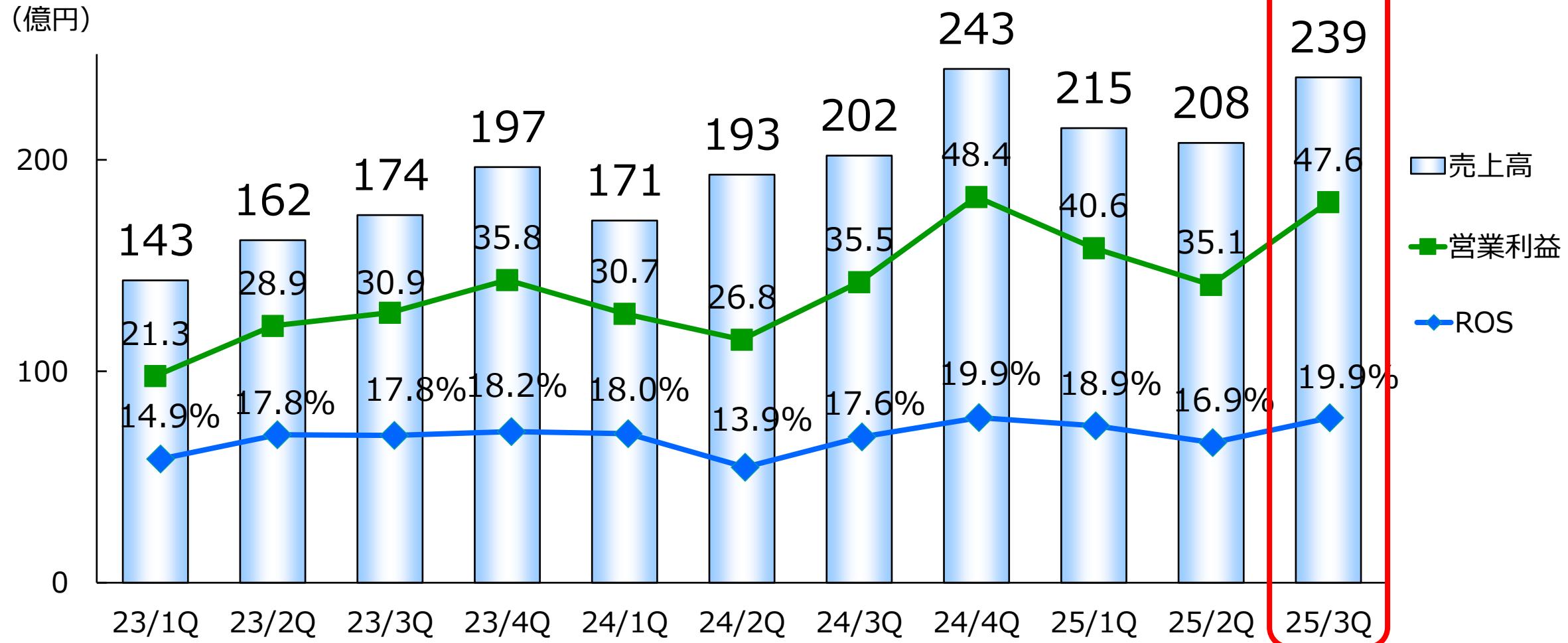
■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比 72%増 (152億円 ⇒ 261億円)
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調で大幅に増加。
FPD後工程及び真空応用装置では、低調で減少。
- セグメント利益 前年比 133%増 (30.2億円 ⇒ 70.5億円)
半導体後工程の売上増加により大幅増益。
- 受注高 前年比 71%増 (157億円 ⇒ 270億円)
半導体後工程では、生成AI用GPUの旺盛な需要継続を受け、先端パッケージ向け装置が好調に推移。
FPD後工程及び真空応用装置では、市況の影響を受け低調に推移。

2025/3Q 実績 (5)

売上高・利益・ROS

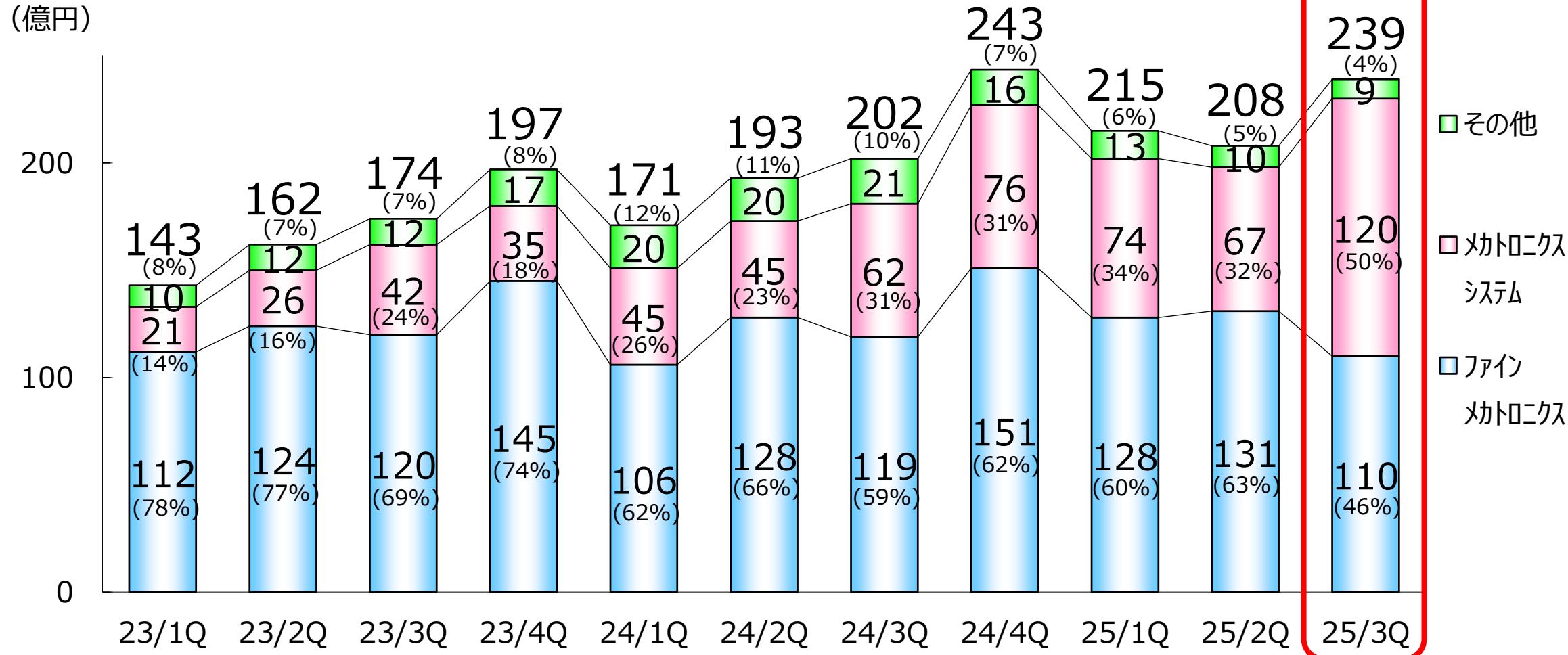


2025/3Q 実績 (6)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 46%
メカトロニクスシステム 50%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



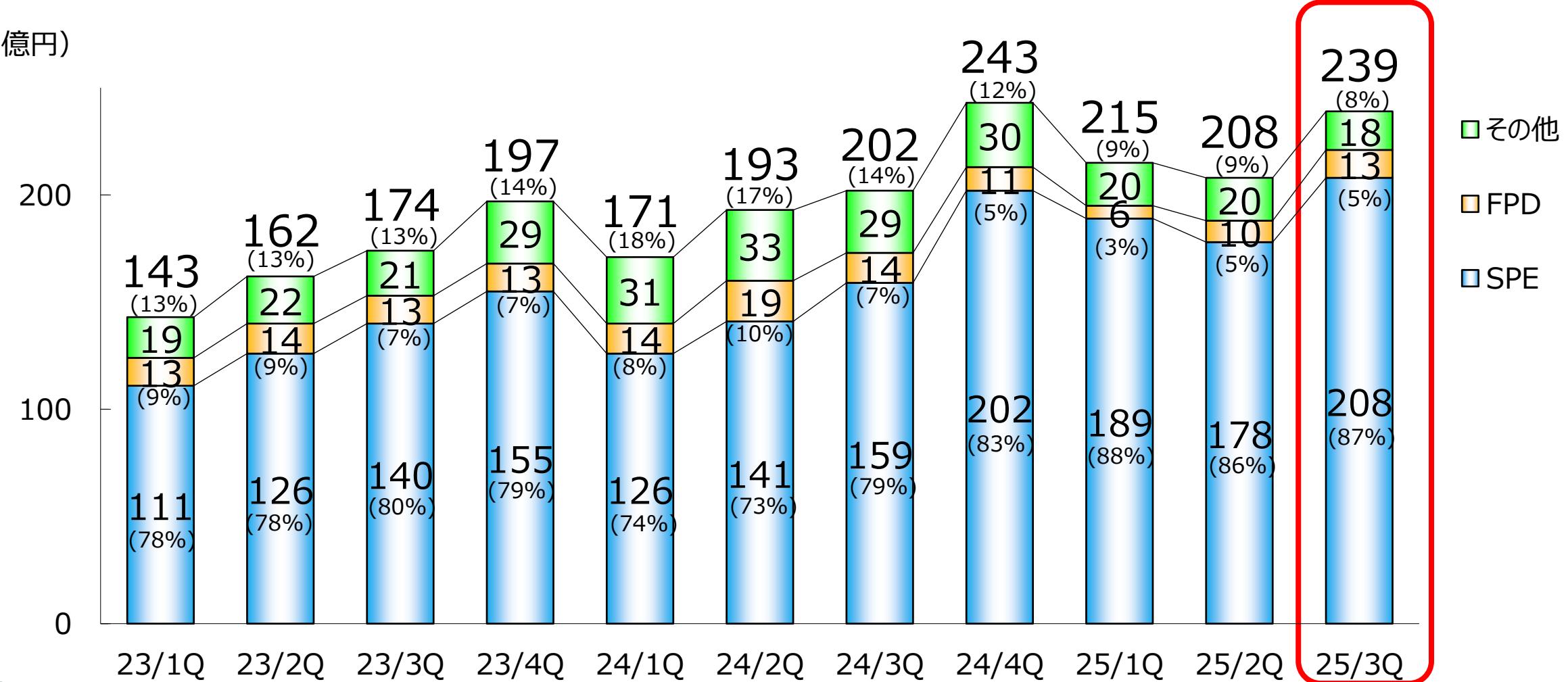
2025/3Q 実績 (7)

分野別売上高

SPE分野 87%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

(億円)

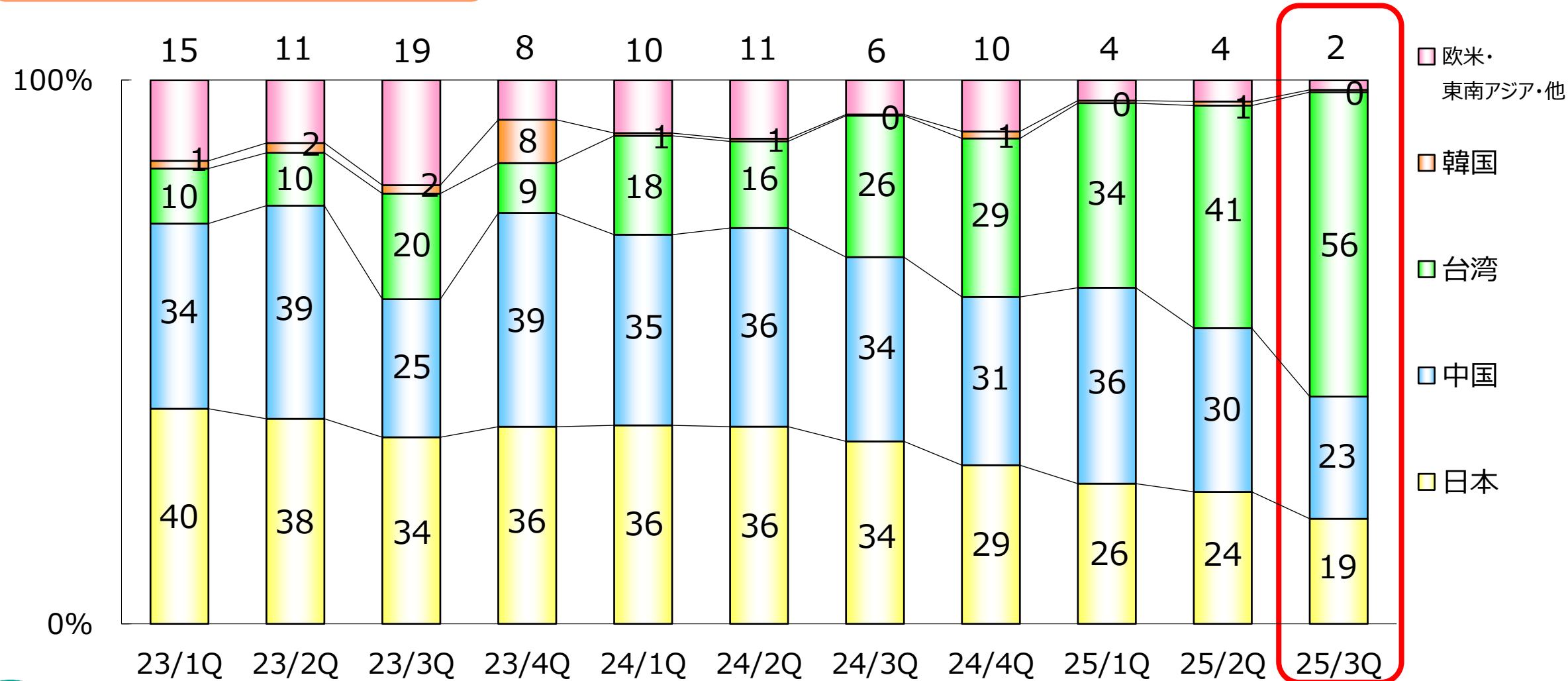


2025/3Q 実績 (8)

地域別売上高比率

海外向け81%（台湾56%、中国23%）

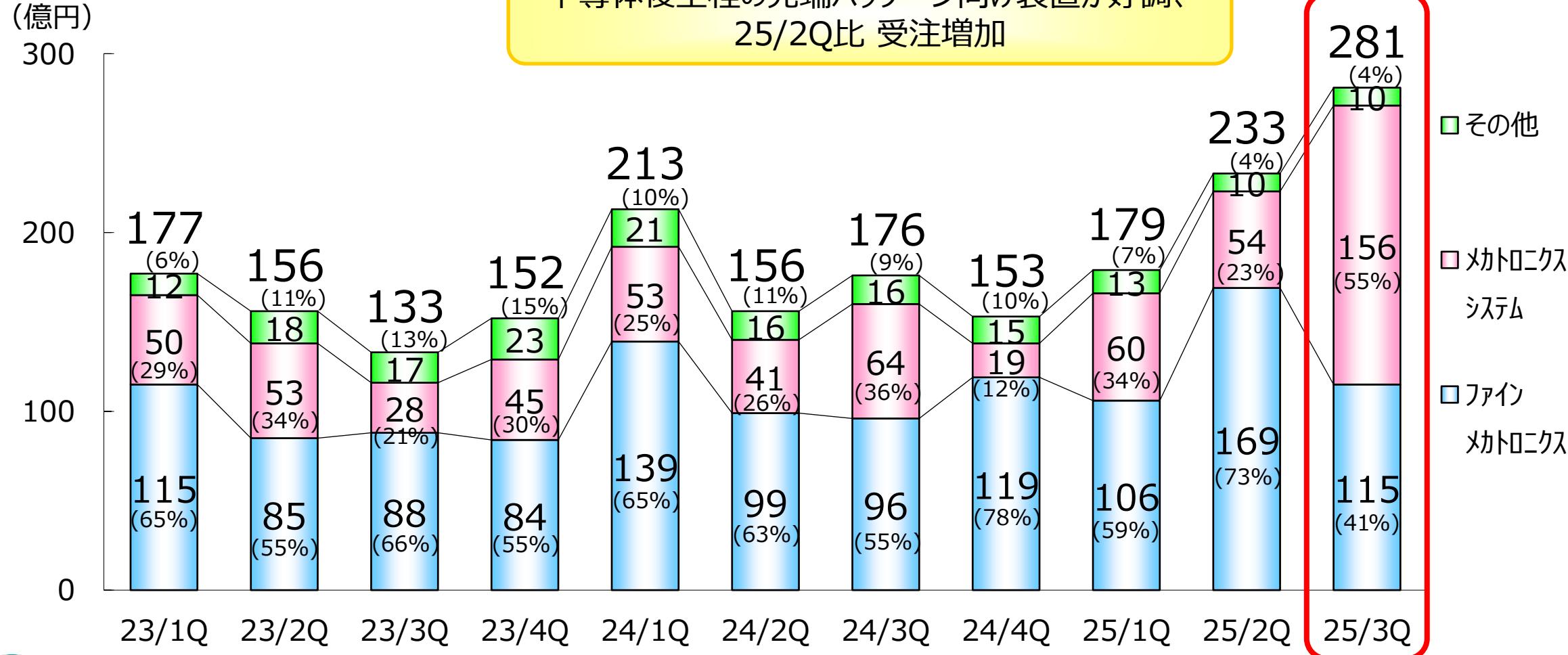
* 仕向地で区分



2025/3Q 実績 (9)

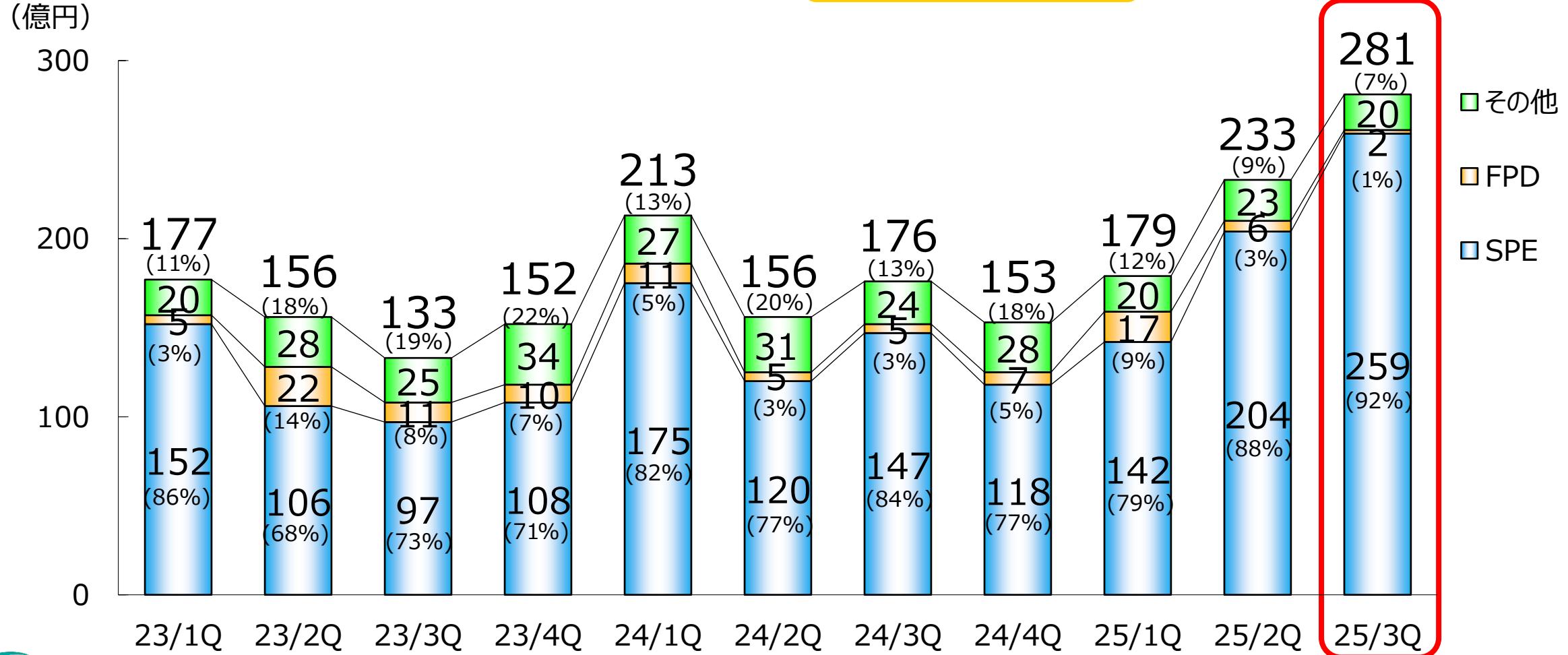
セグメント別受注高

* ファインメトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



2025/3Q 実績 (10)

分野別受注高

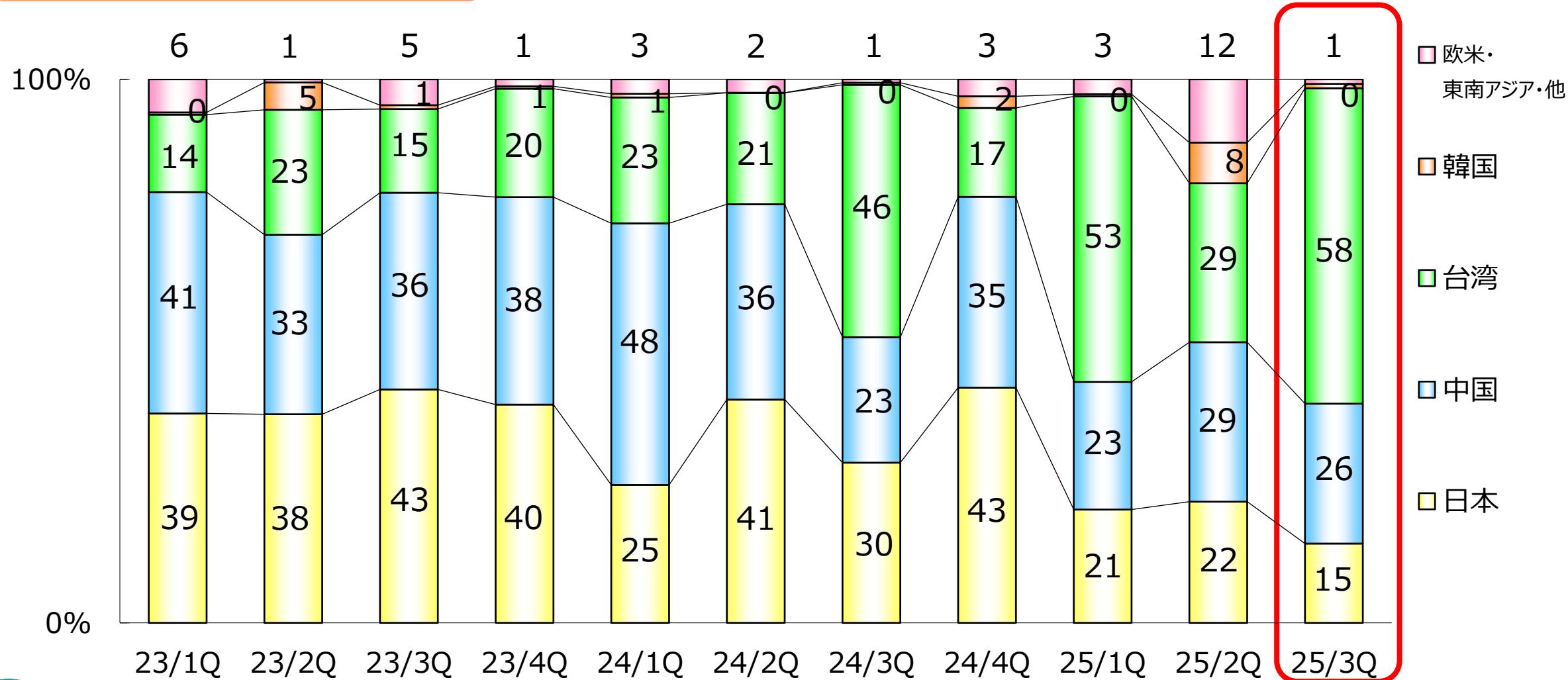


2025/3Q 実績 (11)

地域別受注高比率

海外向け85% (台湾58%、中国26%)

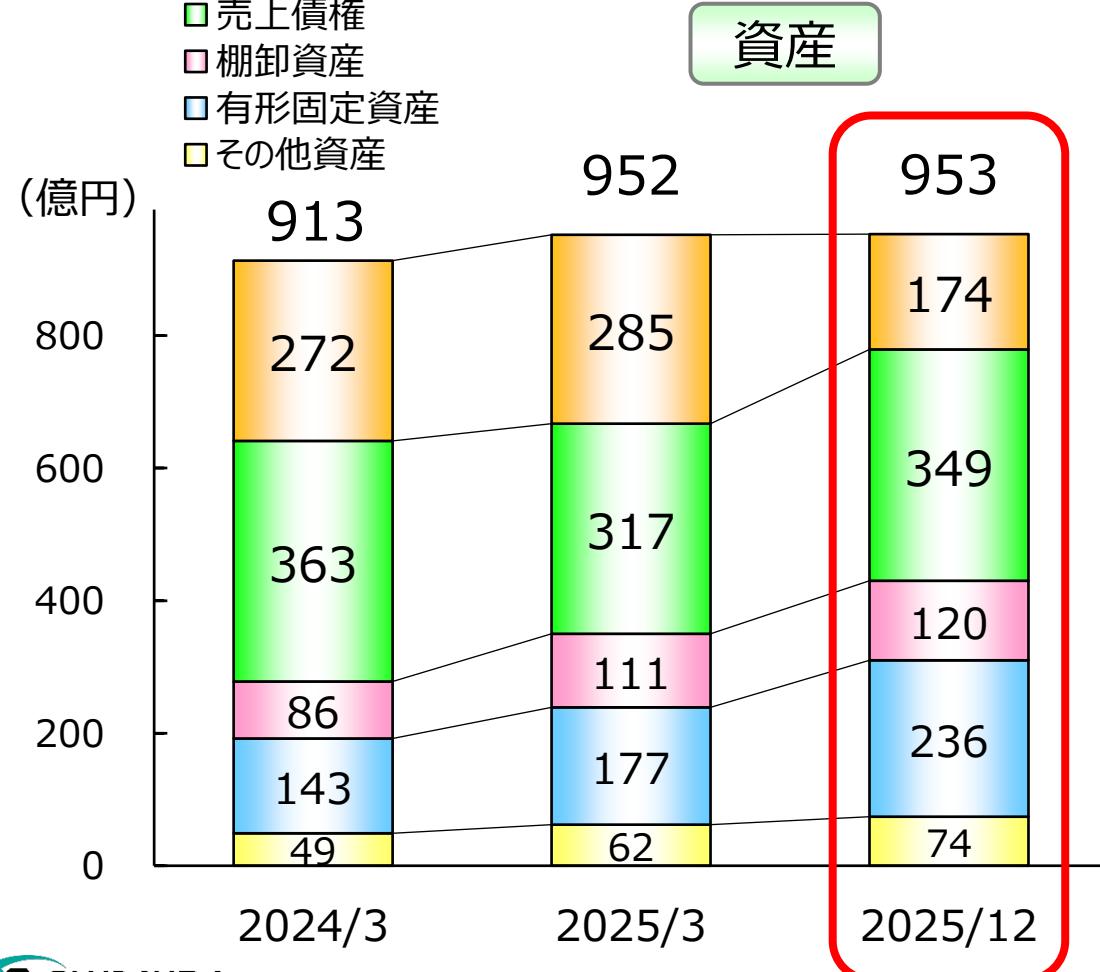
* 仕向地で区分



2025/3Q 実績 (12)

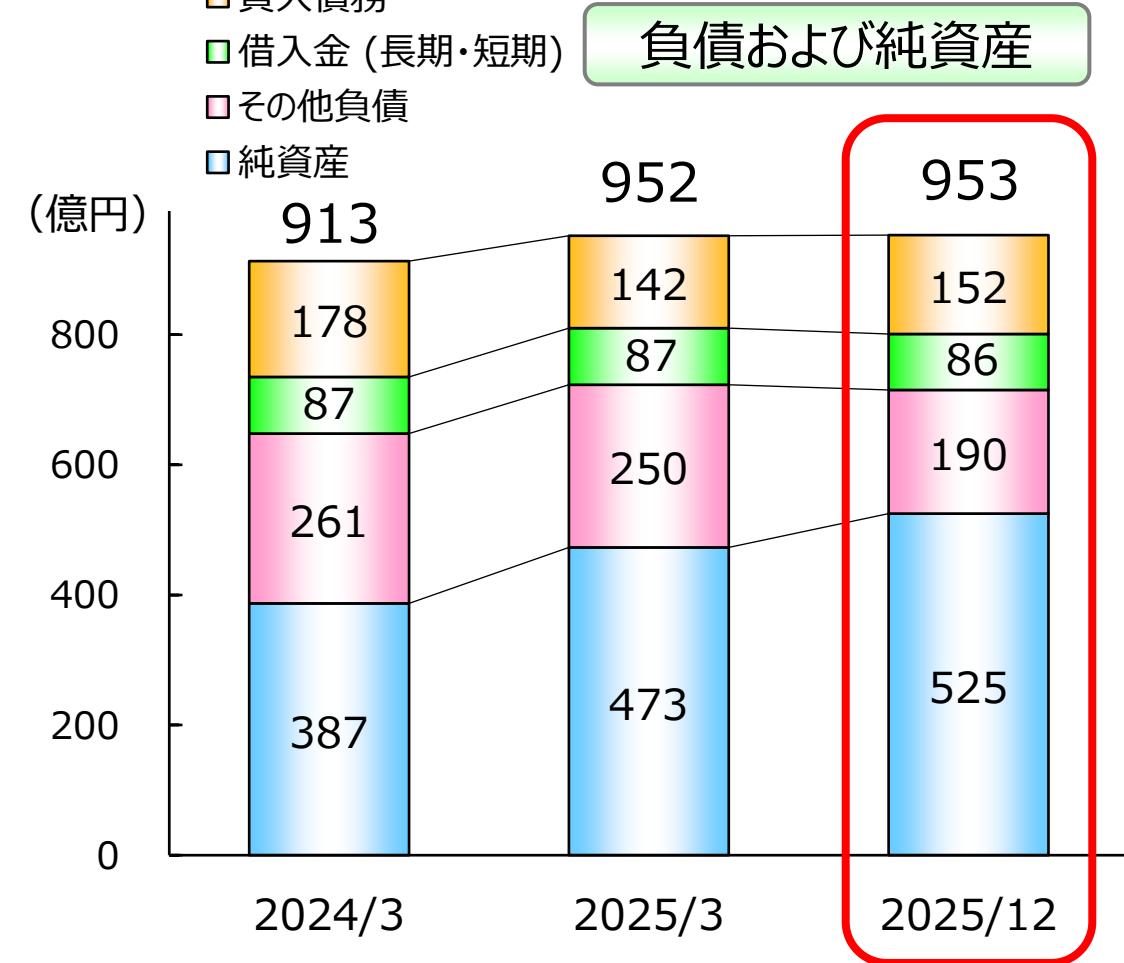
貸借対照表

- 現金・預金
- 売上債権
- △ 棚卸資産
- △ 有形固定資産
- △ その他資産



自己資本比率 50% ('25/3) → 55% ('25/12)
D/Eレシオ 0.18倍 ('25/3) → 0.17倍 ('25/12)

- 買入債務
- 借入金 (長期・短期)
- △ その他負債
- △ 純資産



2025年度 業績予想 (1)

業績予想

2025年度は前回予想から
売上高、利益とも上回る見込み

*1: 2025年5月公表, *2: 2025年11月公表

(単位: 億円)

	2022 年度	2023 年度			2024 年度			2025 年度 予想
			24/3Q 累計	24/4Q		25/3Q 累計実績	25/4Q 予想	
売上高	610	676	566	243	809	662	218	880
営業利益	109.1	116.9	93.0	48.4	141.4	123.3	26.7	150.0
R O S	17.9%	17.3%	16.4%	19.9%	17.5%	18.6%	12.2%	17.0%
経常利益	105.1	116.1	91.8	48.0	139.8	121.0	25.5	146.5
当期純利益	92.0	87.9	69.5	33.8	103.3	88.5	19.5	108.0
ROE	31.9%	24.5%	-	-	24.0%	-	-	21.2%
FCF	32.0	36.8	-	-	37.7	-	-	-41.8

前回予想 *2 2025 年度	期初予想 *1 2025 年度
835	800
125.0	105.0
15.0%	13.1%
121.0	101.0
89.0	75.0
17.5%	15.8%
-41.8	6.0

2025年度 業績予想（2）

配当予想

当社は、連結配当性向をおおむね35%を目指しています。

2025年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は前回予想から増配。

また、1株につき5株の割合で株式分割するため、期末配当は58.0円を予定しています。

（分割前290円に相当、配当性向 35.2%）

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想（2026年3月期） (株式分割前換算)	0円	※ 58.0円 (290円)	※ 58.0円 (290円)
前回予想（2026年3月期）	0円	238円	238円
期初予想（2026年3月期）	0円	200円	200円

（ご参考） 2025年3月期 年間配当278円

※2026年3月1日を効力発生日として1株につき5株の割合で株式分割を実施予定。

2025年度 業績予想（3）

株式分割

株式の分割によって投資単位を引き下げ、投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えることにより、投資家層の拡大を図ることを目的としています。

分割の割合	1株につき5株の割合をもって分割
基準日	2026年 2月28日
効力発生日	2026年 3月 1日

	現在	株式分割後
発行済株式総数	13,971,900株	69,859,500株
発行可能株式総数	30,000,000株	150,000,000株

※詳細につきましては、本日（2026年2月5日）公表しました「2026年3月期 通期連結業績予想及び配当予想の修正並びに株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

トピックス

* GNT：現中期経営計画
グローバルニッチトップ
対象製品群

- グローバルニッチトップ対象製品群の売上順調
 - 3Q : SPE売上高 208億円の内、GNT 153億円 (74%)
 - 累計 : SPE売上高 575億円の内、GNT 416億円 (72%) で推移
- 先端パッケージ向け装置：生成AI用GPU用途を中心に引き続き受注好調
- 先端パッケージ向けPLP用途のウェット処理装置：上市、R&D用途で受注獲得
- 枚葉式リン酸エッチング装置：設備投資需要回復基調、受注が高水準で推移
- 枚葉式Siウェーハ洗浄装置：一定の引き合い継続、堅調に推移
- マスク向け装置：エッチング装置、洗浄装置とも引き合い増加、順調に推移

【ご参考：当社ホームページ】
[＜半導体製造装置 | 芝浦メカトロニクス株式会社＞](#)

この先もずっと、
人と技術で
社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、
「Smart」, 「Solutions」, 「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、
豊かな社会の実現を支えてまいります。



見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。